

半导体设备涨价周期正式启动，行业正从周期复苏迈向盈利扩张新阶段。近期全球存储芯片产业掀起新一轮扩产热潮，AI 驱动的 HBM 需求爆发成为核心引擎：三星电子、SK 海力士相继上调先进制程与 HBM 产能规划，美光科技也在全球多地推进大规模扩产项目，下游资本开支高景气持续得到验证。据伯恩斯坦研报，东京电子、Screen 等日本头部设备厂商依托日元贬值的汇率红利，叠加 AI 产业链的强劲需求拉动，已正式向下游客户发起提价，其中 SK 海力士已收到 3%-4% 的涨价诉求。若本轮涨价全面落地，设备厂商的毛利率与营业利润率将迎来显著增厚，板块投资逻辑也将从前期的周期复苏主线，正式切换至盈利扩张逻辑。花旗同步给出乐观预测：2028 年全球晶圆厂设备市场规模将达到约 2500 亿美元，并已上调应用材料(AMAT.US)、泛林集团(LRCX.US)等美股半导体设备龙头的目标价。在此产业趋势下，国内半导体设备赛道有哪些核心个股值得重点布局？

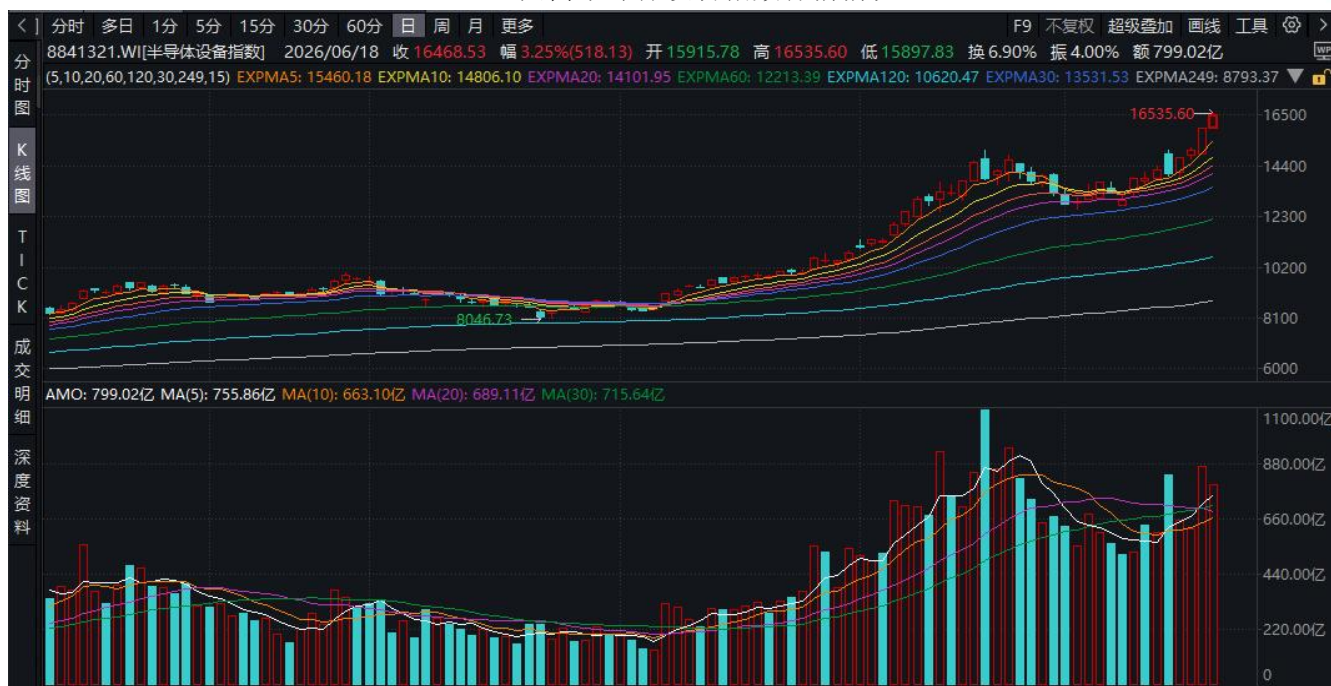
半导体设备涨价周期启动，行业有望步入盈利扩张新阶段

半导体设备行业正式开启新一轮涨价周期。据伯恩斯坦最新研报确认，东京电子、Screen 等日本半导体设备龙头已正式启动提价策略，SK 海力士已收到 3%-4% 的涨价请求。本轮涨价由日元贬值、AI 需求爆发、行业供需格局偏紧三大因素共同驱动，是行业供需关系逆转的明确信号。与此同时，行业长期成长空间也迎来大幅上修，花旗首次给出 2028 年全球晶圆厂设备 (WFE) 乐观情景预测，市场规模将达到 2500 亿美元，2026-2028 年分别为 1450 亿、2000 亿、2500 亿美元，年复合增速超 30%，核心增长动力来自 Agentic AI 带动的 NAND 存储需求结构性爆发，以及全球晶圆厂的持续扩产浪潮。

伴随涨价落地与需求放量，板块投资逻辑正迎来关键切换，主线将从前期的“周期复苏预期”转向“盈利扩张兑现”。若本轮涨价顺利落地，设备厂商的毛利率与营业利润率将迎来显著提升，叠加下游需求持续放量，行业将正式进入“量价齐升”的戴维斯双击阶段。对于国内设备厂商而言，海外设备涨价与交期拉长将进一步加速国产替代进程，国内具备核心技术壁垒、已进入主流产线验证的设备厂商将迎来订单与盈利的双重提升，建议重点布局平台型龙头与细分赛道隐形冠军。



图一：国内半导体设备指数行情情况



资料来源：Wind

➤ 涨价周期启动：供需格局逆转，设备厂商提价

*涨价核心驱动：供需格局变化

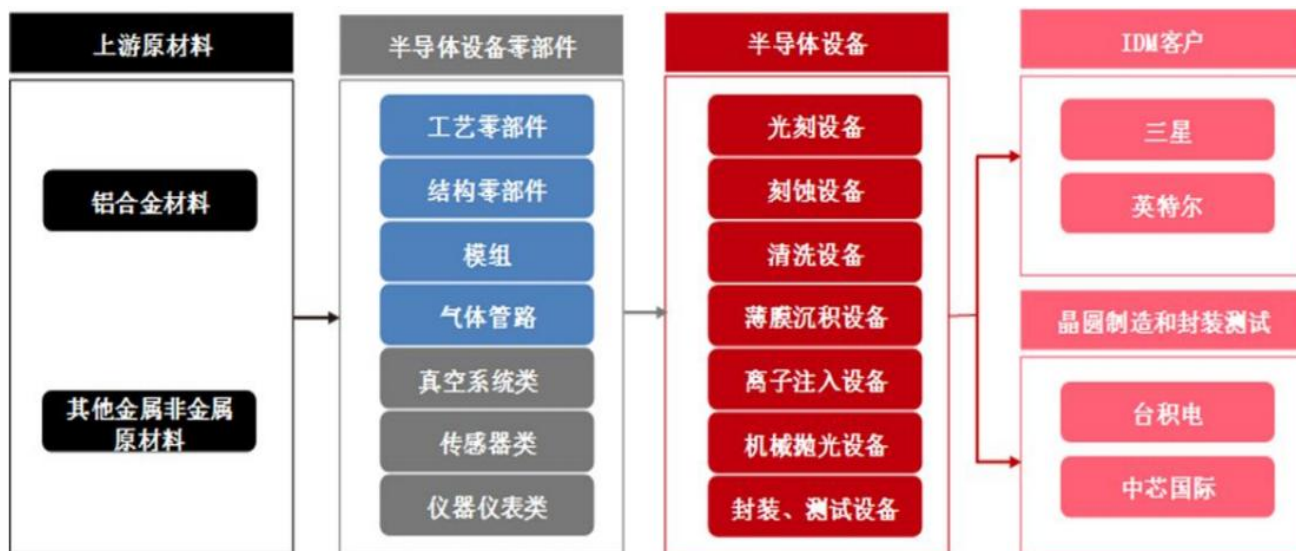
需求端来看，AI 产业的超预期爆发正成为半导体设备需求增长的核心引擎，其中 Agentic AI (智能体 AI) 的快速落地，正在引发 NAND 闪存需求的结构性跃升。不同于传统大模型的单次推理，智能体的多步骤推理、工具调用与自主决策 workflow，会大幅放大键值缓存的容量需求；同时企业级 SSD 正从传统的被动存储载体，逐步转向承担大模型主动推理缓存层的核心角色，这一定位质变直接推高了云端与企业级市场的存储采购规模。受此驱动，三星、SK 海力士、美光三大全球存储巨头纷纷上调 2026-2027 年的资本开支计划，加速 NAND 闪存与 HBM 高带宽存储的产能扩张。与此同时，先进制程逻辑芯片的扩产节奏也在加快，台积电 2nm、1.4nm 产线建设持续提速，全球晶圆厂为抢占 AI 芯片产能纷纷提前锁定设备产能，下游抢单现象持续加剧，全产业链的设备采购需求持续超出市场预期。

供给端则持续呈现产能紧绷、交付周期拉长的紧张格局，供需错配态势进一步加剧。当前全球主流半导体设备厂商已全面进入满负荷生产状态，东京电子已将旗下所有生产基地从单班制切换为双班制全力赶产，应用材料、泛林集团等龙头也均处于产能满载状态，但核心设备的交付周期仍持续拉长：刻蚀、薄膜沉积等通用核心设备交期已拉长至 5-8 个月，高端 EUV 配套设备、高精度检测设备等技术壁垒较高的细分品类，交付周期更是超过 12 个月。供给弹性不足的背后，一方面是半导体设备产业



链条冗长，核心精密零部件如真空腔体、光学镜头、高精度控制阀的扩产周期长达 18-24 个月，上游产能难以快速响应下游需求爆发；另一方面，设备研发与装配高度依赖资深技术人才，行业专业人才供给缺口显著，进一步限制了产能爬坡速度。供需格局的持续收紧，也直接赋予了设备厂商较强的定价话语权，为行业开启涨价周期奠定了坚实基础。

图二：半导体设备产业链



资料来源：上市公司富创精密招股说明书

*海外厂商涨价动态：从意向走向落地

据伯恩斯坦最新产业调研显示，日本头部半导体设备商已制定清晰明确的提价路径，相关价格谈判正全面进入实质落地阶段。其中东京电子将定价体系优化列为首要战略目标，采用分三步走的渐进式提价策略：一是针对当前供需紧张下的加急订单收取专项溢价费用，匹配紧急交付的额外产能成本；二是向下游客户逐步传导原材料、人工及物流等通胀带来的成本上涨压力；三是在下一代高端新机型推向市场时，依托技术升级与性能迭代大幅抬高产品定价基准。公司目标将长期毛利率提升至 50% 以上，营业利润率向 35% 靠拢，这一盈利水平显著高于当前市场一致预期。

另一家日本设备龙头 Screen Holdings 则推进两阶段提价计划，第一阶段针对通胀因素的成本传导方案已获得下游客户普遍接受，第二阶段正围绕新机型的技术附加值与性能升级开展涨价谈判，公司长期营业利润率目标设定为 30%。行业层面也已出现明确验证信号，SK 海力士已正式收到设备供应商发出 3%-4% 的涨价请求，这标志着本轮涨价已从设备厂商的战略规划，正式传导至客户端的商务谈判环节，涨价落地的市场概率大幅提升，也进一步印证了行业供需格局的持续收紧。

涨价浪潮并非日本市场独有，全球半导体设备行业正形成普涨态势。应用材料(AMAT.US)、泛林集团(LRCX.US)等美国头部设备厂商也在 2026 年二季度陆续上调部分设备报价，其中高端刻蚀、薄膜沉



积设备等紧缺品类涨幅达 15%-30%。从日本厂商的渐进式提价到美国厂商的高端产品大幅调价，本质上均是 AI 驱动下设备需求爆发、供给产能紧绷的共同结果，全行业性的涨价周期已基本确立，设备厂商的盈利扩张逻辑也将逐步兑现。

► 行业空间展望：AI 驱动长景气，2028 年有望达 2500 亿美元

花旗在最新研报中上调全球晶圆厂设备（WFE）行业规模预期，首次给出 2028 年市场规模测算。乐观情景下，2026 年全球 WFE 市场规模可达 1450 亿美元，2027 年增至 2000 亿美元，同比涨幅 37.9%，2028 年进一步攀升至 2500 亿美元，同比增长 25%；即便参考中性预测，2028 年行业规模也能达到 1930 亿美元，两次情景下的数据均明显超出此前市场一致预判，充分印证半导体设备行业向上的成长空间。

本轮半导体设备景气周期和以往周期性复苏有着本质差异，在 AI 产业赋能下，行业增长具备更强持续性与结构性特征。首先存储行业需求逻辑发生根本性转变，过去存储厂商扩产多跟随消费电子周期起伏，如今由 AI 算力拉动，HBM、高端 DRAM、3D NAND 进入长期扩产阶段，三星、SK 海力士、美光持续加码资本开支，美光更是将 2026 财年净资本支出从 200 亿美元上调至 250 亿美元以上。与此同时，头部晶圆代工厂不断加码先进制程产能布局，台积电、三星、英特尔持续加大建厂投入，花旗测算显示台积电 2027、2028 年资本支出分别为 670 亿美元、750 亿美元，英特尔 2027 年资本开支增速预计可达 36%，大幅超越市场前期预期。

AI 算力建设带来的资本开支热潮自上而下传导至整条半导体产业链。全球头部云厂商未来三年资本开支维持高速增长，机构预计 2026 至 2028 年增速分别为 84%、56%、38%。各大云企业大规模布局 AI 算力基础设施，直接催生海量高端芯片设计需求，倒逼全球晶圆厂持续扩产新建产线，最终转化为大量半导体设备采购订单，形成“云厂商资本投入—高端芯片需求释放—晶圆厂扩产落地—设备订单持续放量”的完整传导链路，为 WFE 行业高景气提供长期稳固支撑。

图三：海外主要大厂资本开支指引上调

科技巨头	最新更新开支计划 (亿美元)		原计划 (亿美元)	变动 情况
亚马逊	2025	1250	1000	上调
微软	2026Q1	349	330	上调
谷歌	2025	910-930	850	上调
Meta	2025	700-720	690	上调

资料来源：ifind



► 国内半导体设备赛道有哪些核心个股值得重点布局？

2026 年初半导体设备板块此前的上涨主要依托行业周期触底复苏的预期，行情以估值修复为主，市场博弈订单与营收回暖，企业盈利尚未迎来明确拐点；而随着海外设备厂商涨价信号陆续落地，板块投资逻辑正式切换至盈利兑现阶段，本轮提价将直接增厚企业毛利率与营业利润率，盈利弹性显著高于营收增速，叠加下游 AI 带动的设备需求持续放量，行业正式迈入量价齐升的盈利扩张阶段，业绩增速将大幅跑赢营收增速，同时 AI 催生的长期结构性需求能够平滑行业传统周期性波动，行业成长属性持续强化，估值中枢具备系统性上移空间，除此之外，海外设备涨价、交付周期拉长也为国内设备厂商创造发展机遇，海内外产品价差收窄提升国产设备性价比，下游晶圆厂出于稳定产能的需求会加速导入国产设备，进一步推动行业国产替代提速。

当前可重点布局平台型全能龙头、各细分赛道设备冠军以及核心零部件优质企业，全产业链充分受益本轮行业涨价与盈利扩张周期。平台型龙头方面，北方华创(002371.SZ)是国内稀缺的全工序覆盖半导体设备企业，产品涵盖刻蚀、PVD、CVD、清洗、热处理等绝大多数晶圆制造核心环节，多品类设备实现规模化批量交付，深度绑定国内外头部晶圆厂，订单能见度已延伸至 2027 年，是行业景气度提升的核心核心受益标的。

测试设备领域，华峰测控 (688200.SH) 是国内模拟及混合信号测试机龙头，国产化率领先行业，高端测试设备持续迭代突破，全面受益于晶圆制造、封测产能规模化扩张。长川科技(300604.SZ)实现测试机与分选机双轮驱动，数字测试机完成关键技术突破，同时斩获国内外大量封测厂订单，成长动能充足。在半导体设备核心控制环节，上海复旦(1385.HK)作为国内优质 FPGA 芯片企业，其产品广泛应用于半导体设备核心控制环节，是国产半导体设备产业链的关键上游配套标的，伴随国内设备厂商规模化放量，公司芯片产品需求持续攀升，业绩增长确定性较强。在晶圆制造环节，中芯国际(0981.HK)作为国内晶圆制造龙头，持续加码成熟制程与先进制程产能扩建，资本开支维持高位，既是国内半导体设备厂商的核心下游客户，自身产能扩张也将持续拉动设备采购需求，同时充分受益于行业整体盈利改善与景气上行。

免責聲明：本報內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本報內容僅供參考，不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券與虛擬資產價格可升可跌，尤其虛擬資產的風險極高，投資者應對有關產品保持審慎及自行承擔投資風險。

